

证券代码：001359

证券简称：平安电工



湖北平安电工科技股份有限公司

Pamica Technology Corporation

（湖北省咸宁市通城县通城大道242号）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二六年十月

本可行性分析报告所述词语或简称与《湖北平安电工科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中“释义”所述词语或简称具有相同含义。

公司拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称“向特定对象发行”），现将本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析说明如下。

一、本次募集资金使用计划

公司本次拟向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 130,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	泰国云母绝缘材料生产基地建设项目	22,413.99	22,243.95
2	泰国电子布生产基地建设项目	43,574.07	42,537.32
3	高性能电子布生产基地建设项目	38,741.06	35,218.73
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		134,729.12	130,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。

本次发行的募集资金到位后，若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

（一）泰国云母绝缘材料生产基地建设项目

1、项目基本情况

本项目计划总投资 22,413.99 万元人民币，拟投入募集资金 22,243.95 万元。公司全资子公司平安泰国为实施主体，建设地点位于泰国北柳府。

本项目拟购置项目建设用地，新建生产厂房及配套辅助设施，采购先进生产设备，项目建成后将有效提升绝缘云母纸、耐高温云母板、新能源安全防护复合材料、耐火云母带等核心产品的规模化生产能力，精准适配东南亚地区及全球市场对云母耐温绝缘材料与新能源热失控防护材料持续增长的市场需求。

2、项目实施的必要性

（1）把握全球市场需求增长机遇，加快海外业务拓展步伐

当前，云母绝缘材料及新能源安全防护复合材料赛道正处于产能与需求同步上行阶段。电网侧，全球电网升级改造持续推进，国内外特高压建设、欧洲电网升级、中东重建及美国数据中心电网扩容共同拉动耐高温绝缘材料需求；新能源侧，新能源汽车、储能、低空经济等赛道热失控安全防护需求集中放量，叠加 GB 38031—2025 电动汽车动力电池新国标落地，进一步夯实了“云母+”安全防护件的长期成长确定性，行业整体进入确定性高增长周期。东南亚地区依托区域贸易协定优势与逐步完善的产业配套条件，正加速承接新能源及电气产业产能转移，区域内对高性能绝缘防护材料的市场需求持续释放。

公司现有产能主要集中于国内，在海外市场的交付时效、物流成本、本地化服务响应等方面存在一定短板，难以充分承接海外市场快速增长的订单需求。本项目的实施将构建公司面向东南亚及全球市场的前沿生产支点，直接对接区域市场旺盛需求，有效缩短海外市场产品交付周期、优化跨境物流成本，是公司抢抓全球产业转移与市场扩容机遇、推动全球市场份额稳步提升的必要举措。

（2）贴近下游客户海外产能布局，提升属地化配套服务能力

近年来，新能源汽车、储能电池、电力电气等下游行业的头部客户加速在东南亚等地区布局海外产能，对上游核心材料供应商提出同步就近配套、属地化交付的要求。就近配套生产能够显著提升供需双方的协作效率，缩短产品验证与迭代周期，是深度绑定核心客户、巩固合作关系的重要支撑。本项目建成后，公司将构建境内、境外双节点联动的供应架构，近距离对接海外客户的研

发与生产环节，快速响应客户的定制化需求与技术迭代要求，进一步融入客户全球供应链体系，强化客户粘性与合作壁垒，巩固并深化与核心客户的长期战略合作关系。

（3）依托东南亚产业集群与 RCEP 政策优势，优化成本结构，提升产品国际定价竞争力

泰国是 RCEP 成员国，地处东南亚核心地带，区位与贸易政策优势突出。依托 RCEP 关税减让与原产地规则简化，公司在泰国生产的产品可享受优惠贸易条件，有效降低跨境贸易成本。同时，泰国 BOI 面向新材料及高端制造产业提供企业所得税减免、进口生产设备及原材料免征关税等优惠政策，可有效降低海外制造基地的初始资本开支与持续运营税负。

在产业配套层面，泰国正加速承接电子信息、新能源汽车及新材料等行业的产能转移，产业集群快速发展，劳动力与要素成本相较国内仍具一定优势，结合当地较完善的工业园区基础设施，可为公司海外生产基地的长期低成本运营提供有力支撑。综合上述多维度成本优化效应，本项目的实施将有效降低公司产品的跨境综合履约成本，构建更具竞争力的成本结构，提升产品在海外市场的综合性价比与定价竞争力。

3、项目实施的可行性

（1）下游需求持续扩容，广泛客户基础为新增产能消化提供保障

云母耐温绝缘材料与新能源热失控安全防护材料是电气装备、新能源汽车、储能等领域的关键基础功能材料，根据弗若斯特沙利文资料，2025 年全球云母产品的市场规模达到人民币 235 亿元，预计 2030 年将增长至人民币 446 亿元，2025 年至 2030 年的年复合增长率预计约为 13.7%，行业发展前景整体向好，市场空间具备持续扩容的充足潜力。从需求结构看，全球电网升级改造持续推进、新能源热失控安全防护要求不断升级，叠加东南亚地区加速承接新能源及电子电气产业转移，区域内对高性能绝缘防护材料的需求持续释放，为本项目新增产能消化提供了充足的市场空间。

公司深耕云母绝缘材料领域多年，在全球市场构建了覆盖广泛的营销服务网络，产品远销全球多个国家和地区，与众多国际知名下游企业建立了长期稳定的合作关系，在行业内具备较高的品牌知名度与市场认可度。伴随全球产业链布局调整，公司核心客户纷纷推进海外生产基地建设，对上游材料供应商的本地化配套能力提出更高要求。本项目建成后能够近距离对接客户需求，优化产品交付效率、提升技术响应速度，进一步深化与核心客户的合作层级，为项目新增产能的消化提供可靠的客户支撑。

(2) 成熟工艺可复制，落地基础扎实

泰国云母绝缘材料生产基地建设项目主要产品为绝缘云母纸、耐高温云母板、耐火云母带及新能源安全防护复合材料，与公司现有主营业务高度契合。公司长期深耕云母材料深加工领域，在云母绝缘材料、新能源安全防护复合材料相关产品的生产工艺、质量控制和设备管理方面已形成成熟体系，可将国内的成功经验复制升级至泰国子公司，构建覆盖全流程的完整制造链条。公司拥有经验丰富的生产管理团队，能够保障泰国基地投产后产能稳步释放、产品品质稳定一致。

(3) 泰国投资环境成熟，实施路径清晰，为项目建设运营提供组织保障

泰国是东南亚重要的制造业中心，拥有完善的产业配套基础设施、充足的劳动力资源和优越的地理位置。近年来，泰国承接了较多的电子信息及新材料行业企业的产能转移，产业集群快速发展。BOI 为外资制造业项目提供企业所得税减免、进口生产设备免征关税等税收优惠政策。同时，泰国作为 RCEP 成员国，与中国及亚太主要经济体之间享有贸易便利，有利于公司降低贸易成本、拓展国际市场。公司泰国云母绝缘材料生产基地建设项目的产品涵盖绝缘云母纸、耐高温云母板、耐火云母带、新能源安全防护复合材料等，与泰国政府鼓励的投资方向高度契合，具备良好的政策环境。

公司通过全资子公司平安泰国实施本项目，股权结构清晰、实施路径明确。此外，公司在新加坡及马来西亚的境外子公司自成立以来运营良好，已在境外子公司运营管理方面积累了成熟经验，为项目实施提供了组织保障。

4、项目投资概算和进度安排

本项目预计建设周期为 24 个月，计划总投资为 22,413.99 万元，本项目建设完成并全部投产后，预计具有良好的经济效益。项目主要投入包括建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费用、基本预备费及铺底流动资金等。

截至本报告公告日，平安泰国已签署土地购置协议，相关地块位于泰国北柳府，土地所有权过户、本项目 ODI 备案登记、泰国当地 BOI 审批及相关登记程序尚在办理中，公司将根据相关要求履行审批程序。

（二）泰国电子布生产基地建设项目

1、项目基本情况

本项目计划总投资 43,574.07 万元人民币，拟投入募集资金 42,537.32 万元。公司全资子公司平安泰国为实施主体，建设地点位于泰国北柳府。

本项目拟购置项目建设用地，新建专业化生产厂房及配套辅助设施，采购高端电子布专用生产设备，重点布局超薄电子级玻纤布、低热膨胀系数电子布及石英纤维布三大产品品类，构建覆盖多品类电子布生产体系。项目建成后将有效提升公司高性能电子布产品的规模化生产能力，精准适配东南亚地区电子制造产业转移、高端覆铜板产能扩张、先进封装产业发展带来的多层次市场需求，同时辐射服务全球市场多元化应用场景。

2、项目实施的必要性

（1）顺应行业高景气周期，加快公司海外业务拓展

电子布制造业正处于由高频高速印制电路板、服务器基板等需求带动的结构性高景气阶段。根据 Prismark 统计及预测，2025 年全球印制电路板市场产值 858.36 亿美元，同比增长 16.7%，预计 2030 年将达 1,446.10 亿美元，2025-2030 年复合年增长率约 11.0%，其中高多层板及 HDI 板等印制电路板产品需求迅速增长。随着大数据、云计算和高速通信等应用的发展，下游对信号传输效率、可靠性及热稳定性的要求持续提升，电子布产品正加快向高速高频、低介电损耗和低热膨胀系数方向升级。

电子布的生产涉及原材料性能控制、拉丝、织造、表面处理等多个环节，且高端产品通常需经下游覆铜板厂商及终端客户验证，技术、资金和客户认证壁垒较高。未来随着覆铜板及印制电路板向高性能方向迭代，具备稳定产品质量和持续研发能力的电子布制造企业有望获得更大的市场空间。本项目实施顺应行业高景气周期，可加快公司海外业务拓展，保障公司外贸业务的持续交付能力。

（2）深化全球客户协同配套，提升供应链属地化服务能力

印制电路板产业链出海正在重塑供应链格局，多家国内知名印制电路板企业已在泰国、越南布局面向高端服务器、数据中心等领域的高端产能，覆铜板厂商亦跟进海外扩产，直接带动高端电子布的就近配套需求，东南亚区域市场对电子布产品的需求持续快速增长。

通过在泰国建设生产基地，公司可构建境内、境外双节点联动的供应架构，实现对海外客户的快速响应与就近配套，缩短跨境交付周期，降低物流时效波动与单一产能中断风险，巩固并深化与核心客户的长期战略合作关系，提升供应链属地化服务能力，提高公司在全球电子布领域的市场地位与品牌影响力。

（3）优化全球产能布局，依托 RCEP 与 BOI 政策优势增强供应链抗风险韧性

当前全球贸易环境日趋复杂，下游核心客户出于供应链安全考量，对供应商的全球化多点布局与多品类产品交付能力提出更高要求。本次泰国电子布生产基地建设项目的实施，有助于公司构建全球化、多节点的产能与供应链体系，将电子布品类同步纳入全球化产能布局，形成国内与海外协同互补的全梯度多元化产能格局，保障从通用到高端全系列产品对海外客户的持续稳定供应，增强外部冲击下的经营韧性与业务连续性保障能力。

泰国是 RCEP 成员国，依托 RCEP 关税减让与原产地规则简化，公司在泰国生产的产品可享受优惠贸易条件，有效降低跨境贸易成本；泰国 BOI 面向高端制造产业提供企业所得税减免、进口生产设备及原材料免征关税等优惠政策，可有效降低海外制造基地的初始资本开支与持续运营税负。在产业配套层面，泰国正加速承接电子信息等行业的产能转移，产业集群快速发展，劳动力与要素成本

相较国内仍具一定优势，结合当地较完善的工业园区基础设施，可为公司海外生产基地的长期低成本运营提供有力支撑。综合上述多维度成本优化效应，本项目的实施将有效降低公司产品的跨境综合履约成本，构建更具竞争力的成本结构，提升产品在海外市场的综合性价比与定价竞争力。

3、项目实施的可行性

(1) 全球市场规模稳步扩张，优质客户体系支撑新增产能消化

在高端算力、高频高速通信等需求驱动下，低介电、低热膨胀等高端特种电子布的市场增速显著高于行业平均水平；而供给端受技术、认证与设备壁垒约束，扩张速度滞后于需求增长，高端产品紧平衡格局预计仍将延续，为本项目产能消化提供了广阔的市场空间。

公司在特种纤维及电子布领域构建了工业级玻纤布稳基、电子级玻纤布配套、石英布高端突围的三层产品体系，相关产品已获得众多行业知名覆铜板、印制电路板及电子终端企业的认证与认可，与众多行业头部企业建立了长期稳定的合作关系，客户粘性强、合作基础深厚，海外业务规模持续快速增长。伴随核心客户加快海外产能布局，其对从通用型到顶级多品类电子布的一站式采购及属地化配套需求持续释放，为本项目新增产能的顺利消化提供了坚实的客户支撑。

(2) 核心工艺储备完备，技术转移风险可控

公司在电子布领域深耕多年，构建起覆盖原纱前处理、整经织造、表面后处理及成品检测全链条的成熟工艺技术体系，自主掌握工艺配方、张力精准控制、高速织造、在线质量检测、自动化收卷定长、环保型上浆浸润等多项核心生产工艺，可适配不同厚度、不同性能等级电子布的生产制造。本项目产品中，超薄电子级玻纤布是在现有电子级玻纤布工艺基础上的精细化升级，低热膨胀系数电子布、石英纤维布依托公司在改性玻纤、石英纤维领域多年的技术积累，相关技术均已通过国内生产基地的规模化量产验证或完成研发验证，具备产业化基础。公司已建立标准化、可复制的生产制造与全流程质量管控体系，产品执行标准与行业规范接轨，依托东南亚等地子公司的海外项目建设与运营管理经验、完善的技术人才梯队与成熟的外派管理机制，可将国内的成功经验复制升级至泰国子公司，

保障项目投产后产能稳步释放、产品品质稳定一致，技术转移风险可控。公司拥有经验丰富的生产管理团队，可有效保障泰国电子布生产基地建设项目的建设和运营。

（3）泰国投资环境成熟，为项目实施提供有力组织保障

泰国是东南亚重要的制造业中心，拥有完善的产业配套基础设施、充足的劳动力资源和优越的地理位置。近年来，泰国承接了较多的电子信息及新材料行业企业的产能转移，产业集群快速发展。BOI 为外资制造业项目提供企业所得税减免、进口生产设备免征关税等税收优惠政策。同时，泰国作为 RCEP 成员国，与中国及亚太主要经济体之间享有贸易便利，有利于公司降低贸易成本、拓展国际市场。泰国已集聚大量 印制电路板、覆铜板产业链上下游企业，拥有成熟的制造业产业工人队伍，可保障项目建设期工程实施与投产后稳定用工。综合来看，泰国产业基础、硬件配套、外资政策及产业人才条件，能够支撑泰国电子布生产基地建设项目顺利建设投产、长期稳定经营，项目具备可行性。

4、项目投资概算和进度安排

本项目预计建设周期为 24 个月，计划总投资为 43,574.07 万元，本项目建设完成并全部投产后，预计具有良好的经济效益。项目主要投入包括建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费用、基本预备费及铺底流动资金等。

截至本报告公告日，平安泰国已签署土地购置协议，相关地块位于泰国北柳府，土地所有权过户、本项目 ODI 备案登记、泰国当地 BOI 审批及相关登记程序尚在办理中，公司将根据相关要求履行审批程序。

（三）高性能电子布生产基地建设项目

1、项目基本情况

本项目计划总投资 38,741.06 万元人民币，拟投入募集资金 35,218.73 万元。本项目拟由公司全资子公司同力玻纤作为实施主体，在湖北省咸宁市通城县实施。

本项目拟新建专业化生产厂房及配套辅助设施，采购高端电子布专用生产设备，重点布局高性能的超薄电子级玻纤布、低热膨胀系数电子布及石英纤维布三

大产品品类，构建覆盖多品类电子布生产体系。项目建成后将有效提升公司高性能电子布产品的规模化生产能力，全面适配常规印制电路板、高多层芯片封装基板、高频高速服务器基板等不同层级应用需求，精准匹配国内算力基础设施建设、新一代通信技术演进及高端电子制造产业升级带来的多层次市场需求。

2、项目实施的必要性

（1）把握高端算力与高频高速通信带来的高端电子布需求爆发窗口

电子布是覆铜板及印制电路板的核心增强基材，处于“电子布——覆铜板——印制电路板”价值链上游。随着算力基础设施建设加速，高端服务器对印制电路板的层数、信号速度与稳定性要求大幅提升，高端低介电、低热膨胀电子布需求呈倍数级增长。2025 年以来，高端服务器迭代升级、高频通信技术革新带动高频高速印制电路板需求，服务器印制电路板层数从传统 10-14 层增至 22-78 层、单机高端电子布用量攀升 3-8 倍，当前高端特种电子布处于缺货状态。本项目是公司抢抓上述确定性需求窗口、实现高端产能抢先卡位的必要举措。

（2）补齐高端电子布规模化产能短板，完善梯度产品体系

公司三十多年来持续关注石英深加工及下游应用，依托自身在特种玻纤领域拉丝、表面处理、织造和后处理 15 年的工艺积累，形成从石英原矿——石英棒——石英纱——石英布到石英制品的一体化战略布局，对标 6G 通讯用高端材料需求，深度融入高端覆铜板及印制电路板产业链，公司薄型电子级玻纤布已批量供应国内头部客户，超薄电子级玻纤布、低热膨胀系数电子布、石英纤维产品已与头部厂商建立合作。公司现有高端电子布相关技术已完成研发积累并达到产业化条件，亟需通过专业化产线建设补齐高端电子布规模化产能短板，实现高端订单的稳定交付。

本项目的顺利实施有利于优化公司国内产能布局与产品结构，提升多品类电子基础材料国产化供应能力，把握关键材料国产替代发展机遇，巩固公司在特种纤维及电子布领域的行业地位，为公司实现长期可持续发展奠定坚实基础。

（3）优化产能布局结构，提升高端电子材料自主可控能力

长期以来，高端电子布高度依赖日美企业供应，其凭借先发技术、专利壁垒和长期客户认证，占据主导地位。国内企业虽在中低端电子布领域实现一定国产化，但高端电子布尤其是 M8 级及以上高端产品仍存在供给缺口。公司精准卡位服务器用高端覆铜板升级浪潮，已掌握 M8 级及以上高端电子布关键技术。本项目有助于公司填补高端电子布供给缺口、打破海外垄断，提升我国在印制电路板基础材料领域的自主可控能力与竞争实力。

3、项目实施的可行性

(1) 公司技术储备扎实，具备高端电子布全流程工艺能力

公司在特种玻纤领域已积累 15 年拉丝、表面处理、织造和后处理工艺经验，并依托三十余年石英深加工及下游应用基础，形成从石英原矿到石英制品的一体化战略布局，公司已掌握 M8 级及以上高端电子布关键技术。公司基于与核心设备厂商长期的商务和技术合作关系，织机设备资源充足，后续产能规模具备进一步提升空间。近年来，公司持续加大研发投入并积极引进优秀人才，截至 2026 年 6 月末，公司拥有各类授权专利 179 项，其中发明专利 43 项，并设有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心及先进材料研究院，构建武汉、通城双研发中心。上述技术、设备、人才与研发体系为项目实施提供了坚实支撑。

(2) 下游需求持续旺盛，公司具备相应客户资源与市场开拓基础

在高端服务器、高速交换机、芯片封装基板等终端需求驱动下，当前下游印制电路板行业持续扩产，多家国内头部印制电路板企业已披露大额印制电路板扩产投资，预计未来 2-3 年行业高端产能将集中释放，行业供给将显著扩容，客户对高端电子布的采购需求持续、明确。

公司特种纤维及电子布业务 2025 年实现收入 13,875.38 万元、同比增长 30.52%，2026 年上半年实现收入 13,276.17 万元、同比增长 98.19%，呈量价齐升态势，公司现有产能利用率持续维持高位。公司超薄系列电子级玻纤布已批量供应国内头部客户，超薄电子级玻纤布、低热膨胀系数电子布、石英纤维产品已与头部厂商建立合作。

(3) 产业政策支持，符合公司战略与行业发展趋势

高端电子布是高频高速覆铜板、芯片封装基板等高端电子产品的核心增强材料，是高端算力基建向上游基础材料传导的关键环节，属于国家鼓励发展的新材料与电子信息基础材料领域，符合新质生产力在基础材料领域的升级方向。“十四五”以来，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《“十四五”原材料工业发展规划》等一系列产业政策密集出台，将高性能纤维及复合材料纳入新材料重点发展方向，鼓励突破高端纤维制备、复合功能化等关键技术，推动新材料在新能源汽车、电子信息、高端制造等领域的国产化替代，提升产业链自主可控水平。

特种纤维及电子布是公司重点打造的新增长曲线，本项目紧密围绕公司主营业务，重点投向高端电子布产能建设，是公司做强新增长曲线、推动“云母+”与“非云母+”材料体系向高端电子材料领域延伸的关键举措，有助于提升公司在特种纤维及电子布领域的核心竞争力。

因此本项目契合公司战略规划，符合国家相关产业政策与行业发展趋势，具有政策可行性。

4、项目投资概算和进度安排

本项目预计建设周期为 24 个月，计划总投资为 38,741.06 万元，本项目建设完成并全部投产后，预计具有良好的经济效益。项目主要投入包括建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费用、基本预备费及铺底流动资金等。

截至本报告公告日，本项目备案、环评手续尚在推进办理中。

（四）补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司拟使用本次募集资金 30,000 万元补充流动资金，以满足公司日常运营资金需求，促进公司主营业务的持续健康发展，提升公司整体盈利能力。

2、项目实施的必要性

（1）公司的业务拓展需要保持较高的资金投入水平

随着公司业务的快速发展，公司在手订单的逐步执行，同时考虑募投项目实施等因素的影响，公司未来营业收入的增长将对营运资金产生较大需求。本次募集资金中部分资金用于补充流动资金，为公司运营资本提供稳定的资金来源，增强公司的可持续盈利能力。

（2）优化公司资本结构，提高抗风险能力

公司通过本次发行股票募集资金 30,000 万元用于补充流动资金，有利于公司保持稳健的财务结构，充实日常经营所需流动资金，提升公司财务支付能力，降低公司财务成本，提高公司抗风险能力，有利于公司长期稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

3、项目实施的可行性

公司本次发行部分募集资金用于补充流动资金，有利于优化公司资本结构，推动公司长期持续稳定发展。本次募集资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》中关于募集资金使用的相关规定，具有可行性。

同时，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、决策、监督等方面做出了明确的规定，形成了规范有效的内部控制环境，规范募集资金的管理和运用。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，顺应行业发展趋势及产业发展政策方向，符合公司战略发展规划和业务定位，有助于公司进一步提高产品产能，优化公司产品结构，提升公司技术和工艺水平，增强公司核心竞争力，彰显公司整体实力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司总资产与净资产规模均相应增加，有利于进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，为公司未来发展奠定良好基础。

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法迅速体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的风险。本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，进一步增强公司的可持续发展能力。

本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业先进地位、把握产业发展机遇的重要战略措施。随着募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。

四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略发展规划以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的合理使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础。因此，本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北平安电工科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》之签章页）

湖北平安电工科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日